

設計者が知るべき 電子機器設計手法の変革！ 次世代技術と設計アプローチ

IDAJ 技術顧問
サーマルデザインラボ代表

国峯 尚樹 登壇



詳細・お申込みはこちら



2025. 8.7 木 14:00 ~ 15:25

電子機器設計において、熱対策・構造強度・ノイズ抑制といった物理設計上の課題は、製品の品質・コスト・納期(QCD)に直結する重要な要素です。

そこで本セミナーでは、従来の「試作・評価・修正」型の開発アプローチから脱却し、設計の上流で課題を予測、対処に関する迅速な判断が可能となる設計手法への転換を、現役エンジニアが自身の設計開発経験をもとに現場目線でわかりやすく解説し、シミュレーション導入によるQCD向上の考え方や、実際のプロジェクトで得られた知見を共有します。

これからの製品開発に求められる「設計力」を高めるためのヒントが満載。次世代製品開発に取り組むすべての設計者の方、設計上流での課題抽出、設計方針の早期決定に悩まれている方にとって、明日から使えるシミュレーション技術の具体的な活用方法や実践的な知見が得られるセミナーです。

プログラム・講演内容(予定)

14:00-14:05	はじめに
14:05-14:30	熱・応力・電磁界の多物理連成解析によるチップレット構造の物理現象可視化 ～熱応力集中とその波及影響の統合評価～
14:30-14:55	ノイズ問題を”後工程”から”先読み”へ～EMCシミュレーションの活用戦略～
14:55-15:20	製品開発における熱流体シミュレーションの活用～CAEによる限界設計への挑戦～ IDAJ技術顧問 国峯尚樹
15:20-15:25	おわりに

開催概要

セミナー名	設計者が知るべき電子機器設計手法の変革！次世代技術と設計アプローチ ～熱・構造・電磁界シミュレーション技術の最前線～
会場	オンライン(LIVEセミナー)
日程	2025年8月7日(木)
開催時間	14:00～15:30
参加対象	・半導体パッケージ、ECU、パワエレ機器など、すべての電子機器の設計に携わっている方 ・熱設計、EMC設計、構造設計に携わっている方、 ・CAE(コンピュータシミュレーション)による製品設計に携わる方、もしくはご興味がある方 ※一部ハードウェアベンダー・ソフトウェアベンダー様にはご参加をご遠慮いただきます。 また、その他弊社都合にてご参加をお断りする場合がございます。 オンラインセミナー受講に際しての、注意事項・動作環境については販促にて記入いたします
受講料	無料(事前登録制)



そのアプローチ、今のままでいいですか？

IDAJが提案する、成果につながるCAE活用の最適解。

電子機器の設計現場に根づく 熱・構造・電磁界のCAE技術 成功の鍵は“技術×ツール”の相乗効果

これからの開発現場に
不可欠なCAE活用のヒントを
設計者の視点からわかりやすくお伝えします！



LIVE 2025. **8.28** 木 **13:00~15:00**

詳細・お申込みはこちら

電子機器の高性能化・高密度化が進む中、設計現場では「熱」「構造」「ノイズ」など、複雑な物理課題への迅速かつ的確な対応が求められています。

本セミナーでは、IDAJがご提供するCAEソフトウェアと解析支援サービスを活用し、設計プロセスを最適化した実践事例をご紹介します。「技術」と「ツール活用」の相乗効果によって、どのように課題を解決できるのか、その具体的なアプローチを、現場目線でわかりやすく解説します。

IDAJは、CAEツールの導入にとどまらず、技術コンサルティングや導入・技術立ち上げ支援を通じて、設計現場の品質・コスト・納期（QCD）改善に向けた継続的なサポートをご提供することで、現場の課題に寄り添いながら、成果につながるCAE活用の実現を目指しています。

これからの開発現場に不可欠なCAE活用のヒントを、お持ち帰りいただければ幸いです。

プログラム・講演内容(予定)

13:00-13:05	はじめに
13:05-13:30	電源回路基板における放射ノイズ発生のメカニズムとDEMITASNXによるノイズ対策 NECソリューションイノベータ 株式会社 様
13:30-13:55	EMC検証環境を強化するIDAJのアプローチとソリューション紹介
13:55-14:20	単体解析では捉えきれないチップレット実装の本質課題 ～多物理連成解析が解き明かす波及劣化と伝送特性変化～
14:20-14:45	IDAJが提供する熱設計課題解決支援のご紹介
14:45-14:55	IDAJの考えるシミュレーション技術で切り拓く「ものづくりプロセス革新」
14:55-15:00	おわりに

開催概要

セミナー名	電子機器の設計現場に根づく熱・構造・電磁界のCAE技術 ～成功の鍵は“技術×ツール”の相乗効果～
会場	オンライン（LIVEセミナー）
日程	2025年8月28日（木）
開催時間	13:00～15:00
参加対象	・半導体パッケージ、ECU、パワーエレクトロニクス機器など、すべての電子機器の設計に携わっている方 ・熱設計、EMC設計、構造設計に携わっている方、 ・CAE（コンピュータシミュレーション）による製品設計に携わる方、もしくはご興味がある方 ※一部ハードウェアベンダー・ソフトウェアベンダー様にはご参加をご遠慮いただきます。 また、その他弊社都合にてご参加をお断りする場合がございます。 オンラインセミナー受講に際しての、注意事項・動作環境については販促にて記入いたします
受講料	無料（事前登録制）

